CO₂レーザ照射時の歯質除去機構

辺見慎吾*1, 古本達明*2, 細川 晃*2, 小谷野智広*2, 上田隆司*3

Mechanism of enamel removal by CO2 laser beam irradiation

Shingo HENMI, Tatsuaki FURUMOTO, Akira HOSOKAWA, Tomohiro KOYANO and Takashi UEDA

歯科医療の分野では、主にレーザ照射に起因して生じる熱を利用して歯質除去などの治療が行われる. そのため、レーザ照射による歯質の除去メカニズムを解明する上で、照射部の温度は重要な要素である. 本研究では、ファイバ導光型赤外線輻射温度計を用いて、CO2レーザ照射中のエナメル質表面温度を測定した. また、エナメル質内部に発生する AE 波を同時に測定し、温度と併せてエナメル質の除去機構を検討した. その結果、エナメル質表面の温度はレーザエネルギの増加にともない上昇した. また、エナメル質の除去に対応して AE 波が発生し、AE 波の発生回数が増えると除去体積が線形的に増加することがわかった.

Key words: laser dental treatment, CO₂ laser, surface temperature, acoustic emission, enamel removal

1.緒 言

歯科医療の分野では、レーザを用いたさまざまな治療法が 提案され、臨床での良好な結果が多数報告されている.レー ザ歯科治療は、主に熱的な治療法であることから温度測定に 関する基礎研究が行われ、熱電対を用いた歯質全体の温度 変化などが報告されている¹⁾.熱電対を用いた測定により、生 体内に蓄積される熱量や歯髄への負荷について検討できる ものの、レーザ照射部の温度は測定が困難であることから報 告が少ないのが現状である.

本研究では、ファイバ導光型赤外線輻射温度計を用いて CO₂レーザ照射時のエナメル質表面温度を測定した.また、 レーザ照射中にエナメル質内部に放出される AE 波を測定し、 温度と併せてエナメル質除去との関係を調査したので、以下 に報告する.

2. 実験方法

本実験では、レーザ照射部の温度を測定するため、ファイ バ導光型赤外線輻射温度計を使用した²⁾.物体表面から輻 射される赤外線は、光ファイバで受光・伝送され、重構造とな っている InAs 素子と InSb 素子の 2 種類の光電変換素子に 導かれる.これらの光電変換素子は感度波長が異なっており、 各素子からの出力電圧の比を取ることで、輻射率やファイバ 端面性状などの影響を受けずに温度が測定できる³⁾.

図1は、出力電圧の比と温度との関係を示している。図中の実線は、温度計を構成する各部品の分光感度特性から求めた理論曲線である。校正試料は、人工歯用材料に使用されるハイドロキシアパタイトのペレット(HOYA(株)製: APP-100)

*1 金沢大学大学院:〒920-1192 石川県金沢市角間町 Graduate School of Natural Science and Engineering, Kanazawa University

- *2 金沢大学理工研究域:〒920-1192 石川県金沢市角間町 Institute of Science and Engineering, Kanazawa University
- *3 名古屋大学大学院:〒464-8603 愛知県名古屋市千種区不老町 Graduate School of Engineering, Nagoya University

学会受付日:2014年	12月	23日〉
採録決定日:2015年	1月	13日〉

を使用し、240℃~785℃の範囲で温度校正を行った.その結果、図に示すように実験結果と理論曲線とが良く一致した.したがって、本研究ではこの理論曲線から温度に換算した.

レーザ照射部の概要を図2に,実験条件を表1に示す.使 用するレーザは CO2 レーザ(SYNRAD 製: 48-1(s))であり, 設 定できるパラメータは歯科用のレーザ治療器とほぼ同等であ る. レーザは, パルス周期を 200 µs とした擬似的な連続波と なっており、デューティ比を変えることでレーザの出力が設定 できる.実験では、レーザの照射時間をt=100 msに固定し、 レーザエネルギEは デューティ比を変えることで制御した.レ ーザおよび光ファイバは、水平面から45°の角度で固定し、照 射領域全体がファイバの受光領域内に収まるようにファイバを 設置した.そのため、歯質表面で照射されるレーザは、0.9 mm×1.2 mm のだ円状となる. また, 使用するファイバは NSG カルコゲナイドファイバであり, 波長が1 µm~6.6 µm までの 赤外線を伝送する. したがって, 波長が 10.6 μm である CO2 レーザは伝送しない.実験試料には、抜去したとトの健全歯 を用い, 研磨機(リファインテック(株)製: Refine Polisher, HV) で水平面を創成したのち,エナメル質に対してレーザ照射し た. 表 2 は、ヒトエナメル質の物性値である 4)~7). エナメル質 は、約96%が無機質のハイドロキシアパタイトで構成され、そ の融点は 1700℃である. AE センサ((株)富士セラミックス製: M5W)は, 創成した水平面上に設置し, 感熱紙を被せて反射





	表1 実験条件	
レーザ	$CO_2(CW)$	
波長	λ [μm]	10.6
レーザエネルギ	E [mJ]	150 - 600
ビーム径	$d_1 \times d_2$ [mm]	0.9×1.2
照射時間	<i>t</i> [ms]	100
パルス周期	<i>t</i> _p [μs]	200
デューティ比	[%]	18 - 65
試料		ヒトエナメル質
光電変換素子		InAs, InSb
光ファイバ	NSG カルコゲナイドガラスファイバ	
コア径	<i>φ</i> [μm]	400
伝送波長	$\lambda_{ m f}$ [μ m]	1 - 6.6

光から保護した. レーザ照射後, エナメル質表面を SEM(日本電子(株)製: VSM-6290LVU)で観察するとともに, 3 次元粗 さ計でエナメル質の除去体積を求めた.

3. 実験結果および考察

図3は、E=400 mJでレーザ照射した際に得られた温度出 カおよび AE 波形である. レーザの出力時間も併せて示す. レーザ照射部温度は、図3(a)に示すようにレーザ照射時間と ともに増加し、レーザ照射が終了すると急激に減少した. ー 方、レーザが ON の状態ではパルスレーザが200 μs 間隔で 定期的に出力されているにも関わらず、AE 波は図3(b)に示 すように不連続的に検出された. AE 波は、エナメル質表面へ の熱の蓄積に起因してエナメル質が除去されるときに生じると 考えられる. このとき、熱が除去組織に奪われ、次に亀裂が発 生するために必要な入熱量を得るまでの時間が必要となり、 AE 波が不連続で検出されたと考えられる. レーザ照射終了 後にも AE 波が検出されたが、これはレーザ照射後の急冷過 程で照射部周辺のエナメル質に亀裂が生じたためと考えられ る.

レーザエネルギと温度との関係を図4に、レーザ照射後に 撮影したエナメル質表面のSEM 画像を図5に示す.エナメ ル質表面の温度は、照射エネルギの増加とともに上昇し、本 実験の範囲では360℃~520℃となり、エナメル質の主成分 であるハイドロキシアパタイトの融点と比較して著しく低かった. また、図5に示すように、レーザエネルギの増加とともにエナメ ル質表面の除去量は増大した.これらの結果から、CO2レー ザに起因したエナメル質の除去は、レーザ照射で生じた熱に よる影響が少ないことが示唆される.

レーザ照射時に発生した AE 波の回数とエナメル質の除去 体積との関係を調べた結果を図6に示す.エナメル質の除去 体積は, AE 波の発生回数が増えるにつれて線形的に増加し, 発生回数と除去体積に相関が認められた.したがって,前述 した温度測定結果と併せ,エナメル質表面の除去はレーザ照

表2 エナメル質の物性 4)~7) $[kg/m^3]$ 密度 2900 - 3000 11×10-6 線膨張係数 [1/K] 0.9 熱伝導率 $[W/m \cdot K]$ 熱拡散率 $[m^2/s]$ 4.2×10⁻⁷ 比熱 753 $[J/kg \cdot K]$ 引張強さ 10 - 35 [MPa] ビッカース硬さ 270 - 366 融点 1700 [°C] (ハイドロキシアパタイト)



図4 レーザエネルギと温度の関係



200 µm

(a) E = 150 mJ



200 µm

(b) E = 250 mJ



(c) *E* = 400 mJ図 5 CO₂レーザ照射後のエナメル質表面

射に起因して生じる表面の溶融ではなく、表面に亀裂が生じ その亀裂が起点となって除去される機械的要因が主因である ことが示唆される.

Er:YAG レーザをエナメル質表面に照射すると,表面温度 が 200℃~400℃となり,エナメル質表面には溶融層が形成さ れないことを報告してきた⁸⁾. また, Er:YAG レーザの波長は 2940 nm であり,水に対する吸収係数が 10⁵ mm⁻¹であること が知られている⁹⁾. したがって, Er:YAG レーザ照射にともなう エナメル質の除去は,主成分であるハイドロキシアパタイト内 の水和基にレーザが吸収されることにともなう機械的な要因 であると報告されている¹⁰⁾. 一方, CO₂レーザの水に対する吸 収係数は Er:YAGレーザのそれと比較して 10 倍以上小さいも のの,同様に吸収特性に優れている. また,エナメル質に対



図6 AE 波発生回数がエナメル質除去に及ぼす影響

するレーザの吸収率は、CO₂レーザとEr:YAGレーザでほとん ど差がない¹⁰⁾. その他、CO₂レーザをエナメル質に照射すると、 エナメル質表面が変質し、溶融・凝固層が形成されることも報 告されている¹¹⁾. これらの要因から、CO₂レーザ照射時の表 面温度が、Er:YAG レーザ照射時の温度よりも高くなったと考 えられる. したがって、CO₂レーザ照射に起因したエナメル質 の除去は Er:YAG レーザのそれと近く、エナメル質内部の水 和基にレーザが吸収されて蒸散する機械的要因と、レーザ照 射に起因して生じた熱による熱的要因が複合的に作用したと 考えられる.

4.結 言

本研究では、CO₂レーザ照射時の歯質除去機構を検討す るため、レーザ照射時のエナメル質表面の温度およびエナメ ル質内部に発生する AE 波を測定した.得られた結果を以下 に示す.

- (1) CO2 レーザ照射時のエナメル質表面温度は、レーザエネ ルギの増加とともに高くなるが、エナメル質の主成分であ るハイドロキシアパタイトの融点と比較して著しく低い.
- (2) エナメル質へのレーザ照射にともなってAE波が観測され, AE 波の発生回数が多くなるとエナメル質の除去体積は 線形的に増加する.

5. 参考文献

- H. S. Malmstrom, S. M. McCormack, D. Fried and J. D. B. Featherstone: Effect of CO₂ laser on pulpal temperature and surface morphology: an in vitro study, J. Dent., 29 (2001) 521.
- T. Furumoto, T. Ueda, N. Kobayashi, A. Yassin, A. Hosokawa, S. Abe: Study on laser consolidation of metal powder with Yb:fiber laser, Evaluation of line consolidation structure, J. Mater, Process. Technol., 209, 18-19 (2009) 5973.
- D. P. DeWitt and G. D. Nutter: Theory and Practice of Radiation Thermometry, John Wiley and Sons Inc., New York, USA (1988).
- 4) 歯科器材調査研究委員会:歯科修復物に望まれる物理的・機械的性質の 適正値について,歯材器, 16, 6, (1997) 555.
- 5) 無機マテリアル学会編:セメント・セッコウ・石灰ハンドブック,技報堂出版㈱, (1996) 160.
- 6) 土井豊, 後藤隆泰, 足立正徳:材料の種類と性質, スタンダード歯科理工学 改訂版, ㈱学建書院, (2002) 40.
- H. Newwesely: High temperature behavior of hydroxy-and fluorapatite, J. of Oral Rehabilitation, 4 (1977) 97.
- T. Furumoto, T. Ueda, A. Kasai and A. Hosokawa: Surface Temperature during cavity preparation on human tooth by Er:YAG laser irradiation, CIRP Ann. 60, 1 (2011) 555.
- 9) F. A. Duck: Physical Properties of Tissue, Academic Press (1990) 61.
- M. Kumazaki and K. Toyoda: Removal of Hard Dental Tissue (Cavity Preparation) with the Er:YAG Laser, J. Jpn. Soc. Laser Dent. 6 (1995) 16.
- 11) F. Hirota and K. Furumoto: Temperature rise caused by laser (CO₂, Nd:YAG, Er:YAG) irradiation of teeth, Int. Congr. Ser. 1248 (2003) 301.